

# FPC用熱硬化型 導電性ボンディングフィルム

## CBF-300 / -W6



CBF-300は、熱硬化型の導電性ボンディングフィルムです。貼り合わせる補強板が金属の場合、FPCのGND回路と電気的な接続を取ることで、金属補強板をシールド層として機能させることが可能です。

### 特徴

#### ▶ GND強化

FPCのGND回路と金属補強板を電氣的に接続することでGNDを強化

#### ▶ 高導電性

特殊金属フィラーの採用により安定した導電性を実現

#### ▶ リフロー耐性

FPCに補強板を接着した後、鉛フリーハンダリフローによる部品実装が可能

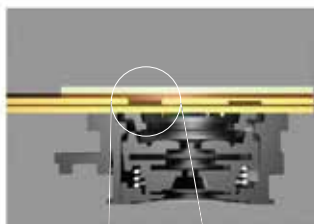
#### ▶ 密着性

SUS、FR-4、PI等の補強板と優れた密着性を実現

### 環境適合性

環境対応	CBF-300/-W6
ハロゲンフリー	適合
RoHS指令	適合
鉛フリーハンダリフロー対応	適合

### 応用例：カメラモジュール

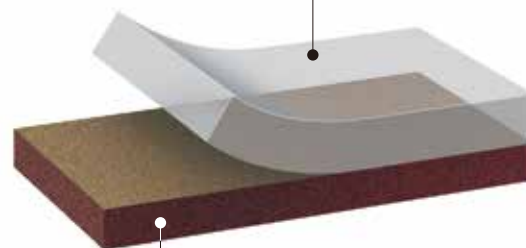


**CBF-300/-W6** 補強板 (SUS、FR-4、PI等)  
FPC

FPCのGND回路とSUSを電氣的に接続。  
CBFでSUSのハイブリッド化を実現。

### CBF-300 / -W6の構成

CBF-300 セパレートフィルム (透明)  
CBF-300-W6 セパレートフィルム (白)



等方導電性接着剤層  
CBF-300:40μm  
CBF-300-W6:60μm